

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券、泾溪投资、新时代证券、中欧基金、诺安基金、中信保诚、平安养老保险、中信建投、混沌投资、中庚基金、浙商证券，共计 17 人
时间	2020 年 7 月 8 日下午 1:00-3:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 史卫利先生 董事、财务总监 威尔东先生 副总经理、董事会秘书 张莉女士 应用技术部&市场部副总经理 南亚雄先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议的主要内容是对无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）整体经营情况的了解，具体如下：</p> <p>1、 公司产能扩张节奏和规模</p> <p>答：2019 年产能 360 吨左右。2020 年预计截至年底，产能扩至 460 吨左右。新厂房正在设计过程中，预计下半年开工建设，有望明年年底投入使用。</p>

2、 下半年以及未来的国内外需求增长情况

答：近期，2020年光伏竞价项目落地，规模达到26GW，同时各省公布的平价项目统计超过17GW，均超于预期，充分激活了下半年需求。目前全球大部分地区光伏电力已经实现或者即将实现平价，我们对于未来全球装机需求保持持续乐观的看法。

综合考虑全球光伏电池产能扩张、大硅片快速大规模使用、以及N型电池量产等导致银浆用量显著增加的因素，即使考虑到短期内MBB对于银浆用量产生的减少影响，我们预计未来3-5年银浆总需求先保持一定幅度上升，然后进入显著增长阶段。

3、 国内外竞争者的竞争力分析

答：导电银浆具有很强的技术驱动属性，产品竞争与技术能力比拼较为激烈。

相对于国外竞争者，帝科也具有强大的研发团队，国际人才、本土人才相结合，并不断扩充强化；在产品迭代升级频率、技术服务强度上均处于领先优势，目前国外竞争者较难跟上我们的步伐，客户对于我们的信赖度很高。

同时，和国内、国外竞争者比较，除了自主研发银粉体系、有机体系外，公司应该是行业内少有的自主设计玻璃配方系统，同时自主生产玻璃系统的光伏银浆供应商，这一块形成了很强的壁垒和供应链安全性。

从产品竞争力看，公司配合多家行业领先客户率先实现了23%以上的P型PERC量产效率和24%以上的N型TOPCon转换效率，均处于领先地位。

4、 公司对于异质结电池发展看法和低温银浆的研发进展

答：异质结电池目前具有很高的市场热度，关注度很高。异质结电池、TOPCon电池均被大家看作P型PERC之后下一代高效

	<p>电池技术之一，目前处于效率、成本、良率、产能等比拼阶段。从综合性价比来看，特别今年 PERC 上大硅片与掺镓片大规模快速导入，可能会对异质结电池发展产生一定的延迟。异质结电池在优化改善转换效率、成本、产能、良率等之后，将是非常有潜力的下一代光伏电池技术。</p> <p>公司作为原材料供应商，对于异质结电池一直保持很高的关注度和技术储备。异质结低温银浆和公司的半导体封装产品同属于低温固化体系，我们在几年前搭建半导体低温固化技术平台时已经将异质结低温银浆纳入了考虑，我们持续跟进异质结市场发展并进行了持续研发。目前异质结低温银浆开发进展顺利，正配合客户进行测试认证中。公司会持续加强研发，确保在异质结电池具备大规模量产条件时，公司处于第一梯度供应商。</p> <p>5、 公司往半导体领域拓展的计划和进展</p> <p>答：半导体电子领域，目前公司产品聚焦在芯片封装环节，芯片固晶粘接产品已处于销售阶段，目前有十家左右小型客户，正在大力拓展中大型客户。在产品线上，公司正在往半导体先进封装、元器件模组封装方向推进，已有相应的产品在配合客户测试。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与来访投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 7 月 8 日